

2010年3月期 決算説明会

2010年5月6日

東京エレクトロン デバイス株式会社

2010年3月期 連結業績

(単位:百万円)

	2009年3月期		2010年3月期		増減率 (%)
		百分比%		百分比%	
売上高	94,701	100.0	85,145	100.0	10.1
売上総利益	14,709	15.5	14,473	17.0	1.6
営業利益	1,840	1.9	2,079	2.4	13.0
経常利益	2,041	2.2	2,117	2.5	3.7
当期純利益	617	0.7	1,166	1.4	88.9
1株当たり当期純利益	5,824.91円		11,000.86円		
R O E	2.9%		5.4%		
1株当たり年間配当金	6,600円		5,000円		
期末従業員数	825人		844人		

2010年3月期 連結資産

(単位:百万円)

科目	2009年3月期	2010年3月期	増減額
現預金	1,245	1,621	375
受取手形・売掛金	15,479	20,890	5,411
たな卸資産	15,879	15,636	242
その他流動資産	3,250	2,987	262
有形固定資産	1,334	1,121	213
無形固定資産	643	464	179
投資その他の資産	2,846	2,925	79
資産計	40,680	45,649	4,968

2010年3月期 連結負債・純資産

(単位:百万円)

科目	2009年3月期	2010年3月期	増減額
買掛金	6,706	7,255	549
短期借入金	3,806	5,105	1,299
その他流動負債	3,969	6,177	2,208
固定負債	4,784	5,198	414
負債計	19,266	23,737	4,470
資本金	2,495	2,495	-
資本剰余金	5,645	5,645	-
利益剰余金	13,351	13,903	551
評価・換算差額等	79	132	53
純資産計	21,413	21,911	498
負債・純資産計	40,680	45,649	4,968

2010年3月期 連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2009年3月期	2010年3月期	増減額
営業キャッシュ・フロー	3,566	225	3,792
投資キャッシュ・フロー	801	100	701
財務キャッシュ・フロー	2,954	703	3,658
現金及び現金同等物 期末残高	1,245	1,621	375

セグメント別連結売上高

(単位:百万円)

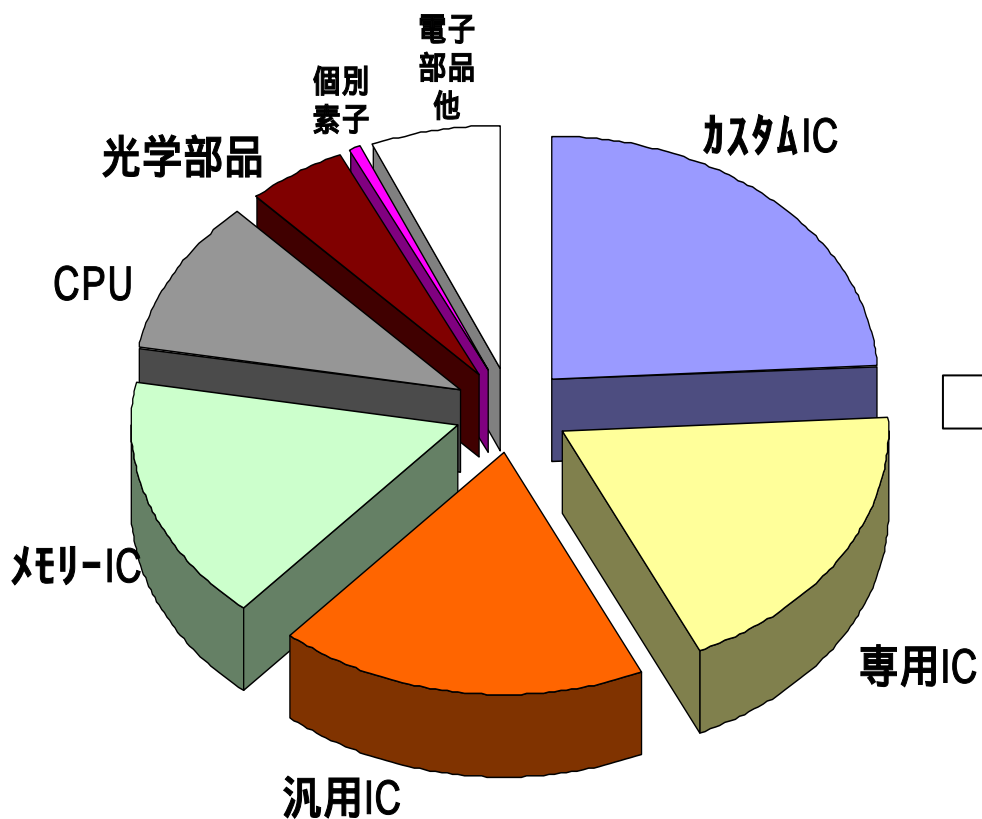
セグメント	2009年3月期		2010年3月期			
	売上高	営業利益	売上高	増減率 (%)	営業利益	増減率 (%)
半導体及び 電子デバイス事業	74,980	736	67,439	10.1	862	17.1
コンピュータ システム関連事業	19,721	1,103	17,706	10.2	1,216	10.3
合 計	94,701	1,840	85,145	10.1	2,079	13.0

半導体及び電子デバイス事業

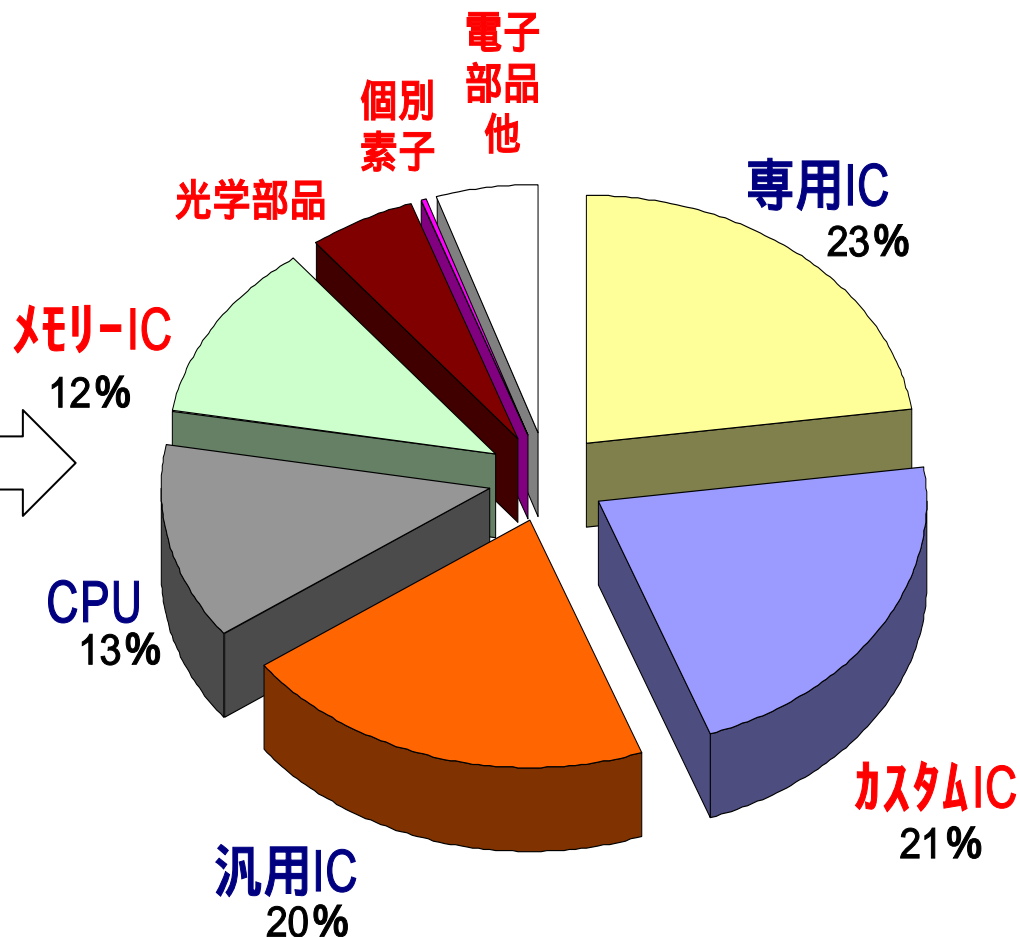


半導体及び電子デバイス事業 品目別 売上構成

< 2009年3月期 内訳 >
売上高: 74,980百万円



< 2010年3月期 内訳 >
売上高: 67,439百万円



* 品目についての説明は、P.30 ~ P.32をご参照ください。

半導体及び電子デバイス事業
主な品目別 売上増減

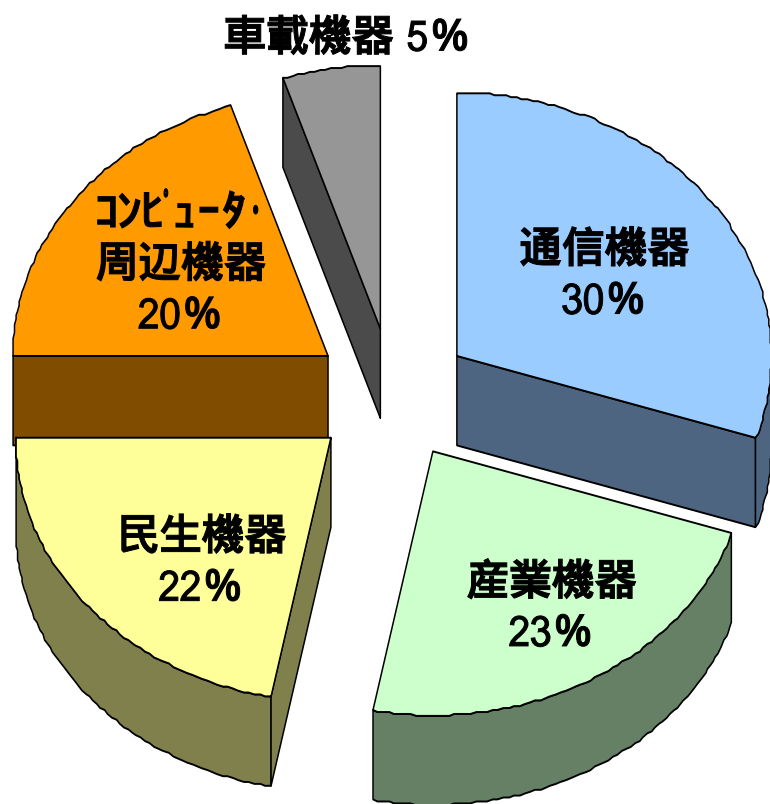
品目	主な仕入先	対前年増減率	主な要因
専用IC	ビクシシステムズ、ビクセルワークス、シリコンイメージ	9%	デジタルTVなどAV機器向け増加
カスタムIC	ザイリンクス、富士通	20%	基地局向け減少
汎用IC	リニアテクノロジー、TI	1%	デジタル家電向け増加、産業機器向け減少
CPU	フリースケール、TI	12%	複合プリンター向け増加
メモリーIC	スパンション	36%	携帯電話向け減少

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

用途別 売上構成

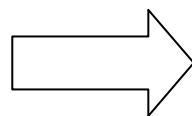
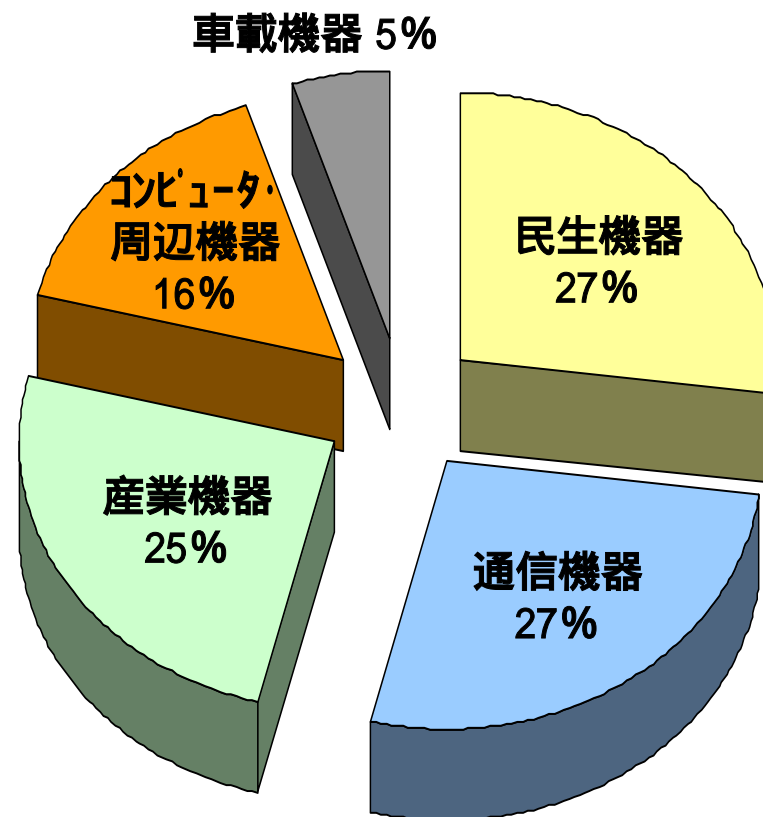
< 2009年3月期 内訳 >

売上高: 74,980百万円



< 2010年3月期 内訳 >

売上高: 67,439百万円

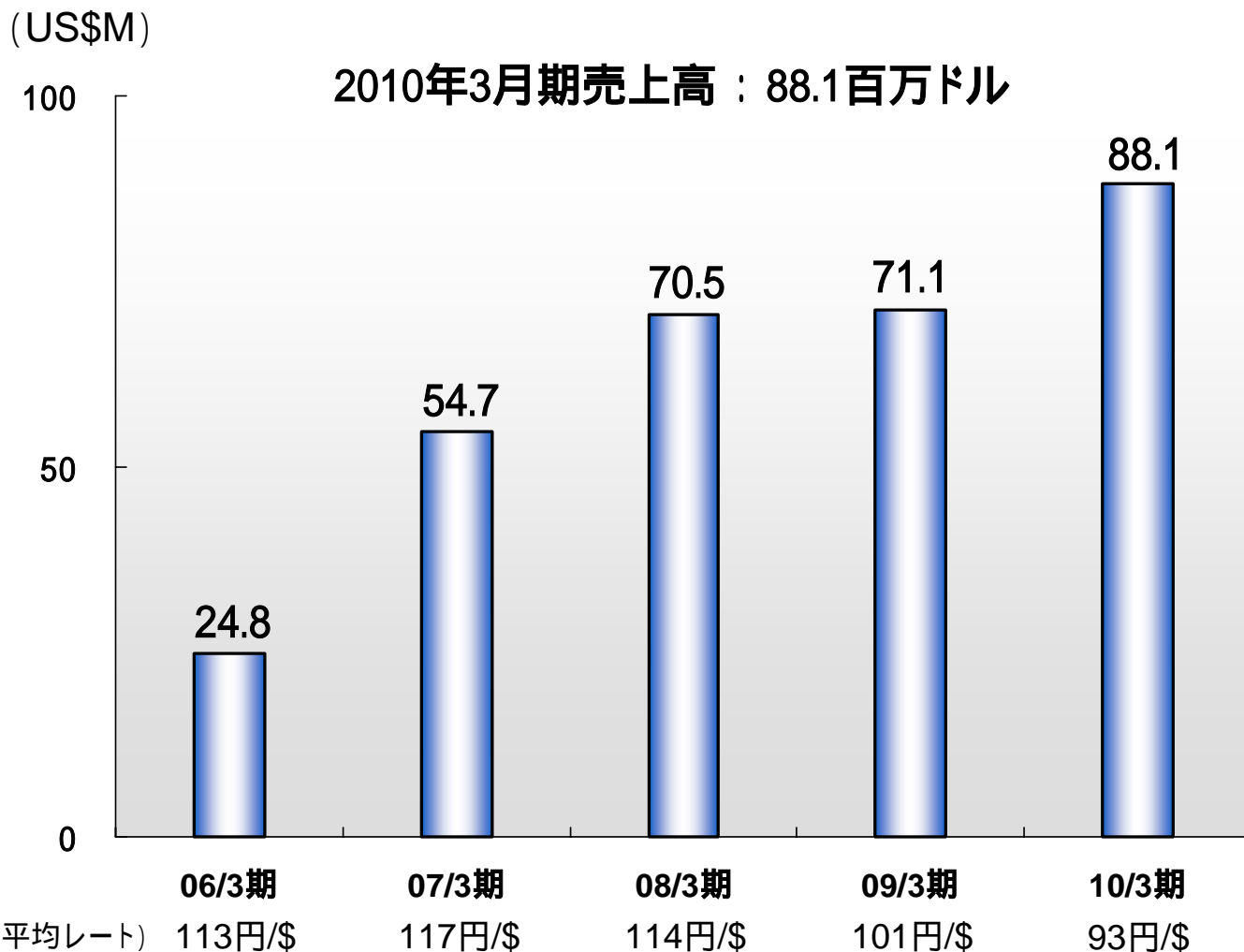


用途別 傾向

用途	主なアプリケーション	主なお客様	当社の傾向
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルTV、AV機器	パナソニック、シャープ、東芝、日立、ソニー	総じて好調
通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、基地局	パナソニック、富士通、日立、NEC	基地局、携帯電話とも低調
産業機器	医療機器、放送機器、テスター、半導体製造装置、ロボット、計測器	東芝、パナソニック、沖、日立、	総じて下期回復
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター、液晶プロジェクタ、PC及び付属機器	パナソニック、富士ゼロックス、NEC、東芝	複合プリンターは堅調だが、その他は低調
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	パナソニック、アイシン	カーナビゲーションは横ばい

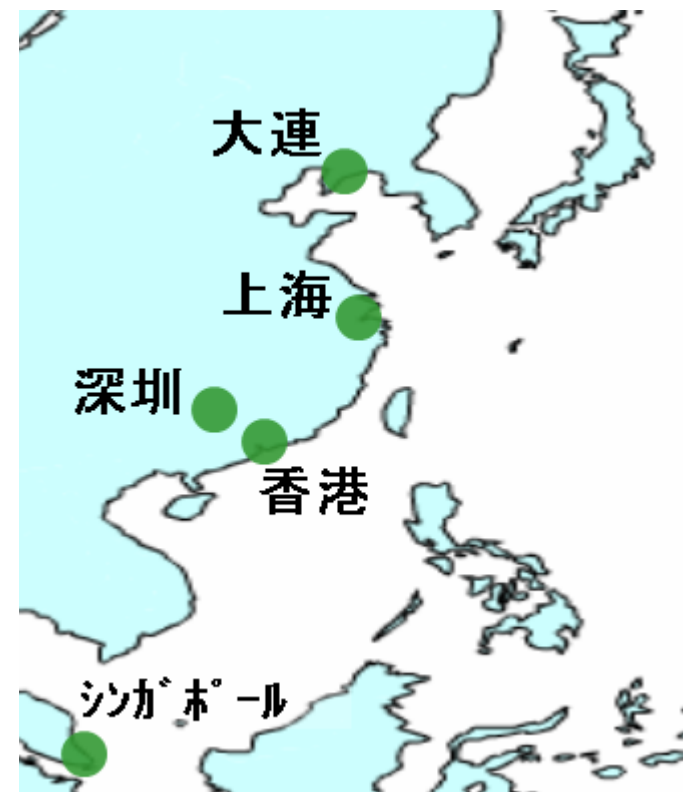
注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

[売上高推移]



[営業拠点]

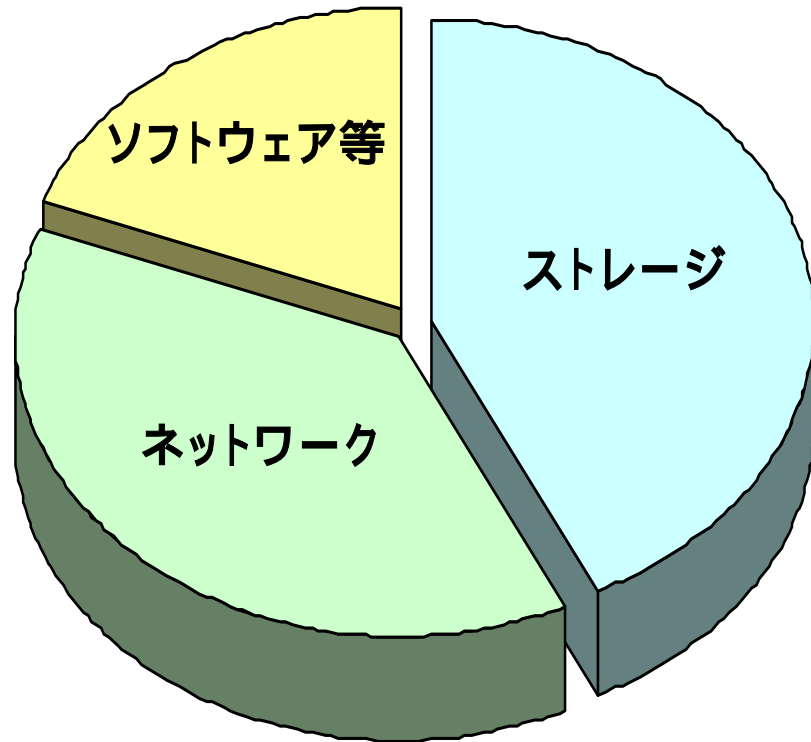
香港、上海、大連、シンガポール
深圳(2009年12月開設)



コンピュータシステム関連事業

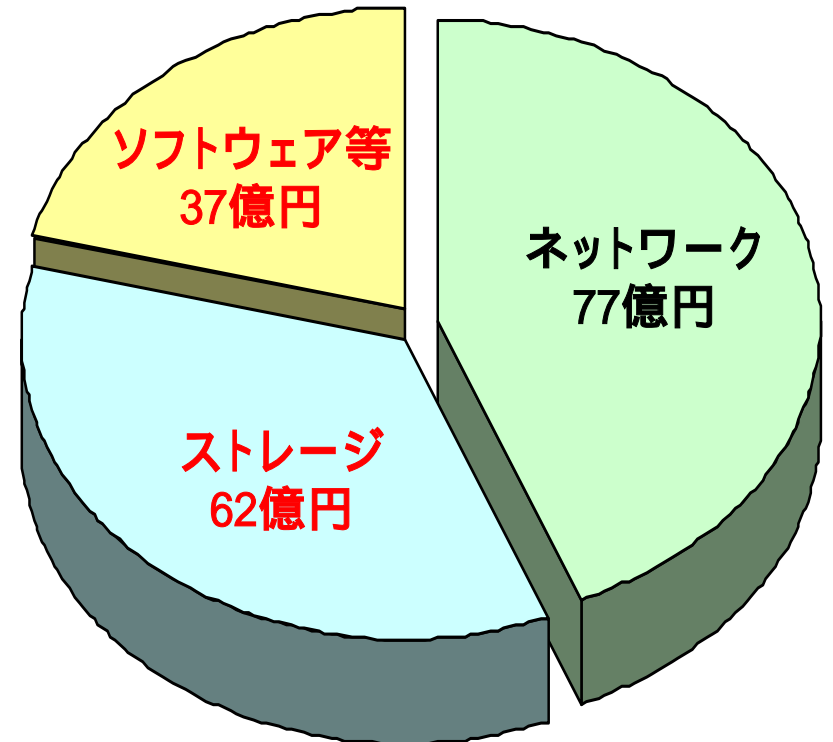
< 2009年3月期 内訳 >

売上高: 19,721百万円



< 2010年3月期 内訳 >

売上高: 17,706百万円



品目別売上増減要因

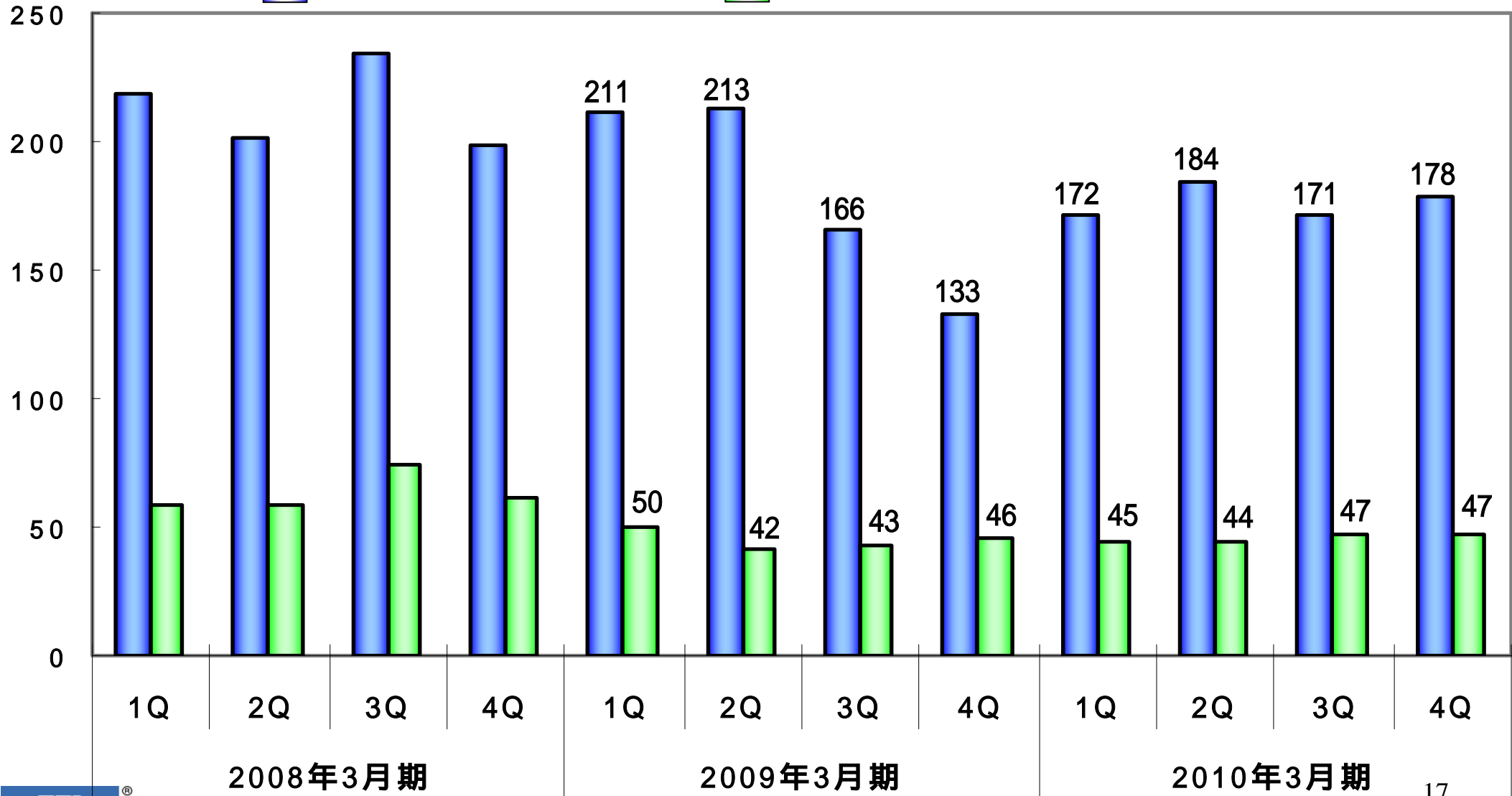
品目	主な仕入先	対前年増減率	主な要因
ネットワーク関連	F5ネットワークス	4%	製品販売は横ばい、保守は増加
ストレージ関連	ブロード	27%	商流の変更により減少
ソフトウェア	マイクロソフト	2%	POS端末向けソフトウェア減少

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

今期の業績予想について

受注高推移

(億円) ■ 半導体及び電子デバイス ■ コンピュータシステム関連



当社を取りまく事業環境 予想

【半導体及び電子デバイス事業】

- ・半導体市場は在庫調整が終了し回復基調
- ・産業機器は回復顕著、民生機器は好調維持、通信機器は前年並み を想定

【コンピュータシステム関連事業】

- ・企業のIT投資は上期慎重、下期回復を想定

セグメント別連結売上高見込み

(単位:百万円)

セグメント	2010年3月期 実績		2011年3期 見込み		対前年 増減率 (%)
	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
半導体及び電子デバイス事業	67,439	79.2	72,500	79.7	7.5
コンピュータシステム関連事業	17,706	20.8	18,500	20.3	4.5
合 計	85,145	100.0	91,000	100.0	6.9

2011年3月期 連結業績予想

(単位:百万円)

	上期予想	下期予想	通期予想	対前年 増減率 (%)
売上高	43,500	47,500	91,000	6.9
営業利益	870	1,820	2,690	29.4
経常利益	850	1,750	2,600	22.8
当期純利益	490	1,150	1,640	40.6
1株当たり配当金	3,000円	3,000円	6,000円	20.0

2011年3月期の活動方針

【半導体及び電子デバイス事業】

新規顧客の開拓、既存顧客の深堀り

地域密着営業を推進

販売ネットワークの全国展開

2010年3月：姫路営業所、広島営業所開設

技術サポートを充実させ商権拡大に注力

新規事業

新規商品の立ち上げ

環境/セキュリティ分野へのプロモーション活動

AC駆動LED、高機能リチウム電池など

2011年3月期の活動方針

【コンピュータシステム関連事業】

販売体制の強化

アカウント営業の推進

営業拠点を活用した販売体制の強化

データセンター向けビジネスに注力

システム構築、製品販売、保守を組み合わせた
ソリューション営業の推進

開発ビジネスについて

inrevium

(インレビウム)

開発ビジネス (インレビウム ビジネス)

お客様要求
設計依頼

市場
マーケティング

設計開発
センター

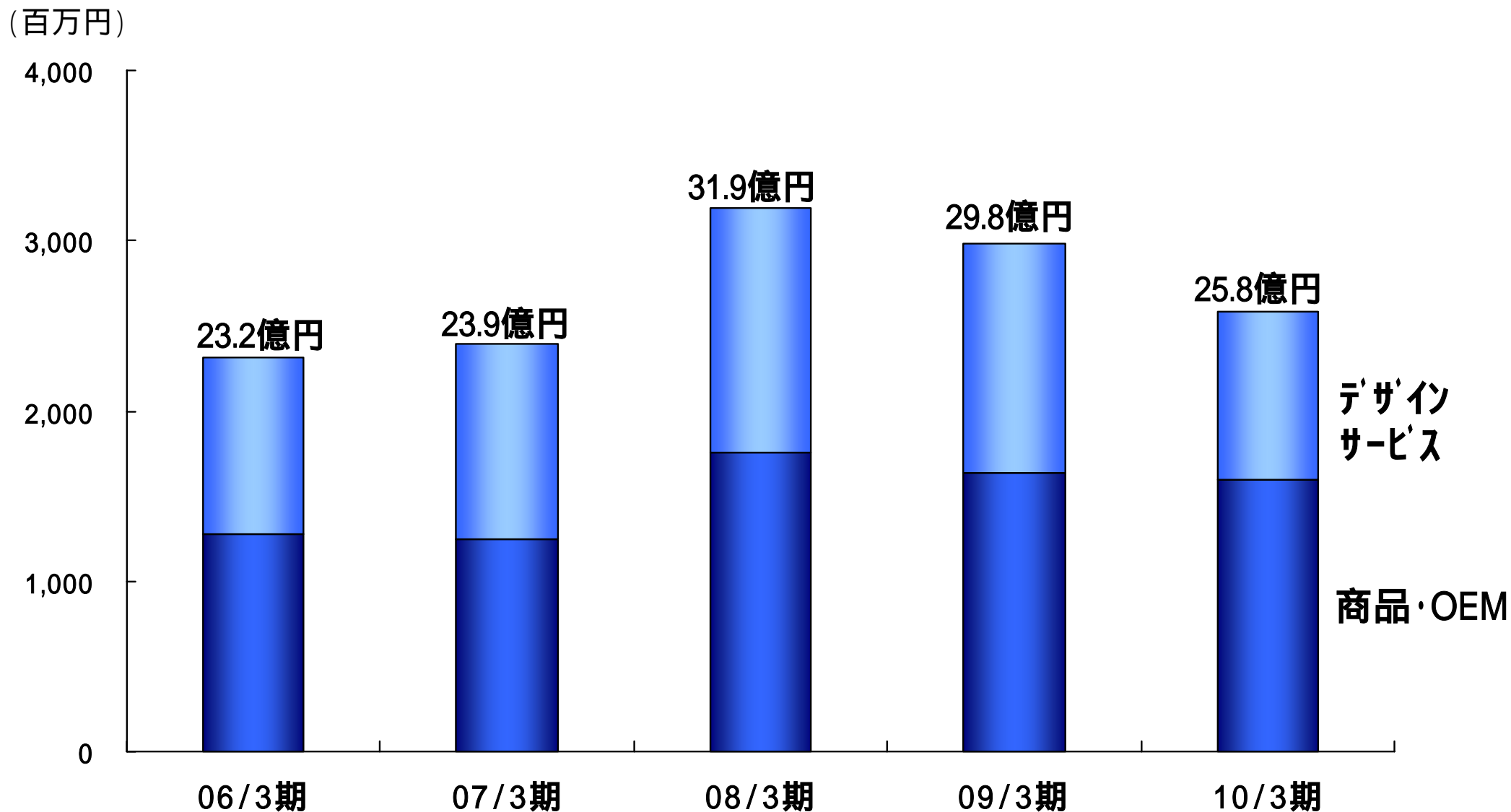


デザインサービス

自社ブランド商品

OEM供給

インレビウム売上高推移

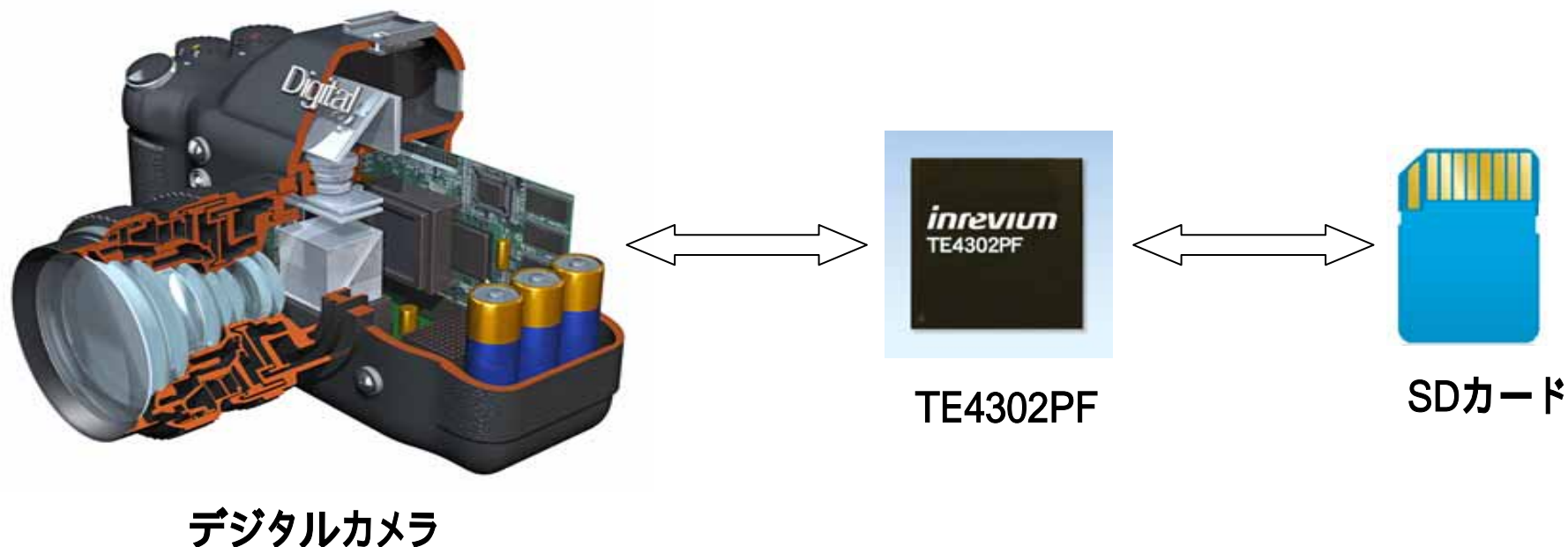


デザイン
サービス

商品・OEM

メモ리카ードコントローラLSI

- ・ SDメモ리카ードの最新規格「UHS-1」対応
- ・ デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ向け
- ・ 2010年3月開発終了、2010年6月より出荷開始



デジタルディスプレイ設計用開発キット

- ・ 設計に必要なハードウェア、ソフトウェアを装備
- ・ ボードには、ザイリンクス社最新FPGA (Spartan-6)を搭載
- ・ 開発期間の短縮、開発コストの低減など効率化を支援
- ・ 2010年1月より販売開始



< 主な最終製品 >
液晶TV、PDPTV、
有機ELディスプレイ、3DTVなど
デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、
監視カメラなどの開発にも応用可能

< 設計受託業務、OEM >

設計受託からOEMへの展開を推進

トップセールスによる営業推進を継続

< 自社ブランド商品 >

セキュリティ関連向け商品群の拡充

メモリーカードコントローラLSIの拡販

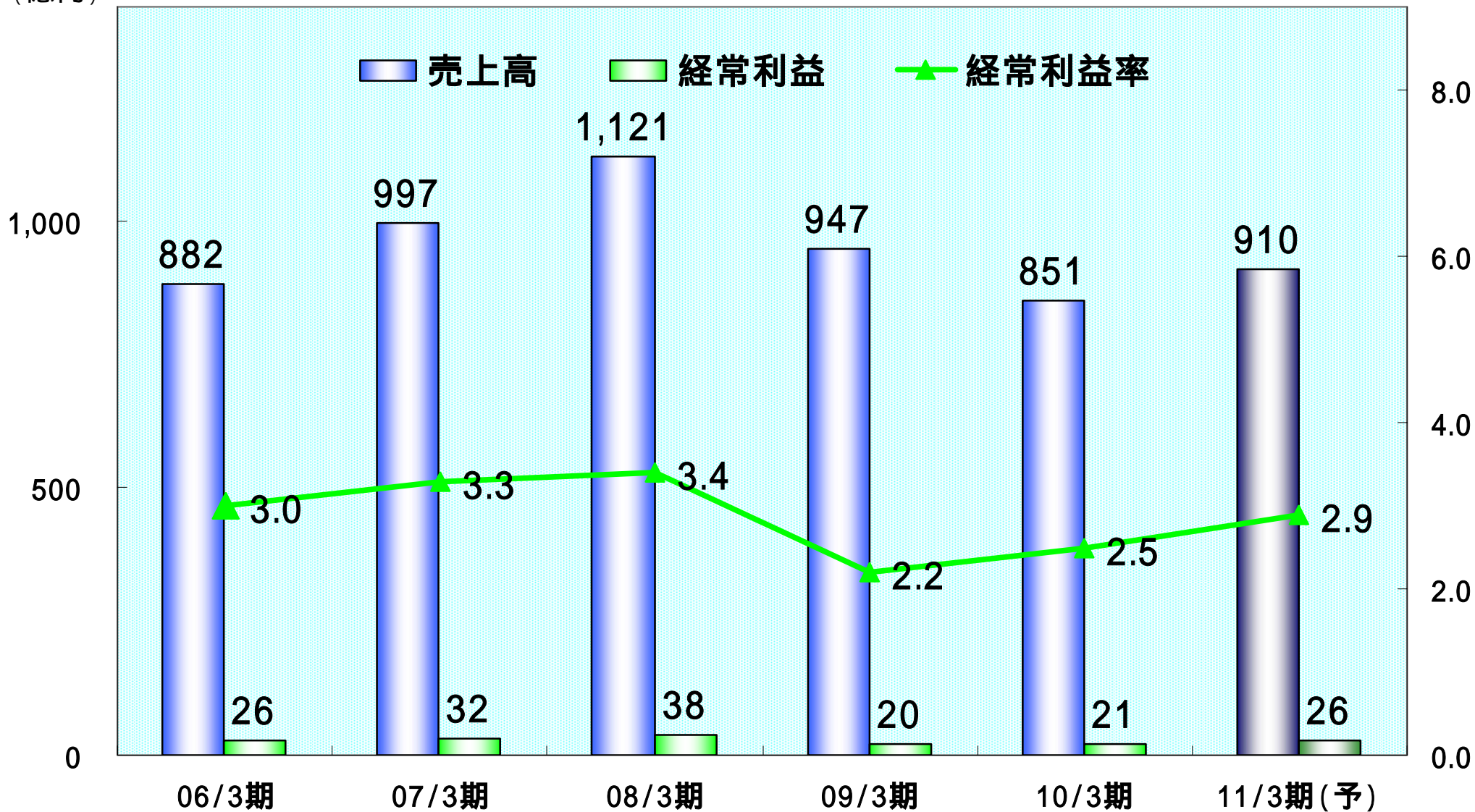
FPGA搭載ボードの開発強化

業績推移・計画

参考資料

(億円)

(%)



セグメント・品目		主な仕入先名
半導体及び 電子デバイス事業	専用IC	加ビウム・ネットワークス社、コネクサントシステムズ社、富士通エレクトロニクス(株)、ビクセルワークス社、シリコンイメージ社、ビクシシステムズ社、ザ・リンク・セミコンダクター社、インビーム
	カスタムIC	富士通エレクトロニクス(株)、ザ・リンクス社、インビーム
	汎用IC	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、TI社
	CPU	フリースケール・セミコンダクター社、富士通エレクトロニクス(株)、TI社
	メモリーIC	IDT社、ラムトロンインターナショナル社、富士通エレクトロニクス(株)(スパンション)
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	個別素子	オン・セミコンダクター社
	電子部品他	コーセル(株)、インビーム
コンピュータシステム 関連事業	ネットワーク機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
	ストレージ関連	ブロード社、エミュレックス社
	ソフトウェア	マイクロソフト社、オラクル社

【半導体及び電子デバイス事業】

品目	主な取扱商品	機能
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用デジタルIC	色々な用途に共通に使用されるIC
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
メモリIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品
電子部品他	ボード、電源、コネクタ	プリント配線基板の上にIC、電源、コネクタなどの 部品を実装した製品(ボード)

【コンピュータシステム関連事業】

ネットワーク関連		インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器。
ストレージ関連		SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。
ソフトウェア等		セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト 社のソフトウェア。

資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。